

Informationen zur Recherchenstrategie

Pilotphase (vgl. ABI. EPA 2015, A86)

Die Art der auf diesem Blatt enthaltenen Informationen kann sich während des Pilotprojekts zur Verbesserung des Nutzens dieses neuen Dienstes ändern.

Anmeldenummer

PCT/EP2019/086644

ERFINDUNGSBEZEICHNUNG: VERFAHREN ZUM VERKAPSELN MINDESTENS EINES TRÄGERSUBSTRATS; ELEKTRONIKMODUL UND WERKZEUG ZUM VERKAPSELN EINES TRÄGERSUBSTRATS

ANMELDER: ROGERS GERMANY GMBH

IPC-KLASSIFIKATION: H01L21/56, H01L23/16, H01L23/31

PRÜFER: Ronnås, Katharina

KONSULTIERTE DATENBANKEN: WPI, ANSERA

KLASSIFIKATIONSSYMBOLLE, DIE DEN RECHERCHENUMFANG DEFINIEREN:

IPC:

CPC: H01L21/565, H01L23/3121, H01L23/16, H01L23/3135

FI/F-TERMS:

SCHLAGWÖRTER ODER SONSTIGE ELEMENTE, IN DENEN DIE ERFINDUNG VORKOMMT:

The invention concerns a method for encapsulating an electronic device using a mold, the mold comprising an insert through the mold to the device. The insert keeps an area free from encapsulating material so that it can be filled later with electrically conductive material. Electrically conductive elements are placed between the electronic device and the insert.